USB2.0 HUB 控制器集成电路

USB 2.0 HIGH SPEED 4-PORT HUB CONTROLLER

SL2.1A

数据手册

Data Sheet

CoreChips ShenZhen CO.,Ltd

内容目录

第一章 管脚分配	3
1.1 SL2. 1A 管脚图	. 3
1.2 SL2.1A 管脚定义	
第二章 功能叙述	.5
2.1 综述	. 5
2.2 充电支持	. 5
第三章 电气特性	5
3.1 极限工作条件	. 5
3.2 工作范围	. 6
3.3 直流电特性	
3.4 HS/FS/LS 电气特性	. 6
3.5 ESD 特性	. 6
附录一 封装	7
表格目录	
表格 1: 最大额定值	
表格 2: 工作范围	6
表格 3: 直流电特性	7
插图目录	
图 1: SL2.1A 管脚图	3
图 2: 附录 封装图	7

第一章 管脚分配

SL2. 1A 管脚图

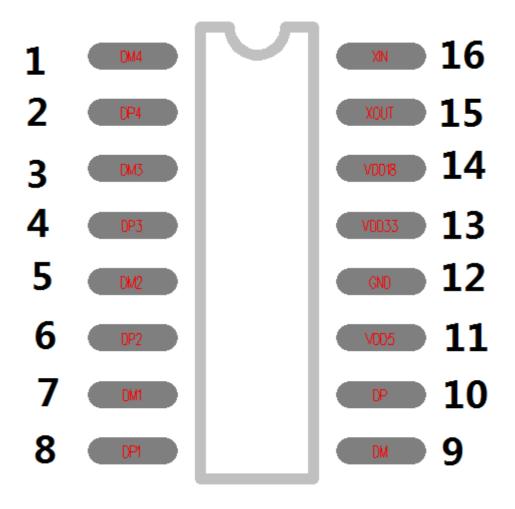


图 1: SL2.1A 管脚图

SL2.1A 管脚定义

管脚名称	16 Pin#	Die	IO类型	定义		
DM4	1		В	下行口 4 的USB DM信号		
DP4	2		В	下行口 4 的USB DP信号		
DM3	3		В	下行口 3 的USB DM信号		
DP3	4		В	下行口 3 的USB DP信号		
DM2	5		В	下行口 2 的USB DM信号		
DP2	6		В	下行口 2 的USB DP信号		
DM1	7		В	下行口1的USB DM信号		
DP1	8		В	下行口 1 的USB DP信号		
DM	9		В	上行口的USB DM信号		
DP	10		В	上行口的USB DP信号		
VDD5	11		P	5v输入		
GND	12		P	芯片地		
VDD33	13		P	内部 3.3v		
VDD18	14		P	内部 1.8v		
XOUT	15		О	晶振PAD		
XIN	16		I	нн укт АБ		

注释: O, 输出; I 输入; B 双向; P 电源/接地;

第二章 功能叙述

2.1 综述

SL2.1A 是一颗高集成度,高性能,低功耗的 USB2.0 集线器主控芯片;该芯片 采用 STT 技术,单电源供电方式,芯片供电电压为 5v,内部集成 5V 转 3. 3V,只需在外部电源添加滤波电容;芯片自带复位电路,低功耗技术让他更加出众。

芯片可以使用外部晶体,也可以使用内置晶体。如果使用内置晶体,需要将芯片的 XI 输入接地。建议您使用外部晶振,使用外部晶振更加稳定*。*

- 完美支持 USB2.0 高速(480MHz),USB2.0 全速(12MHz),和低速模式(1.5MHz)
- 集成 12M 晶体振荡器
- 集成 12MHz-to-480MHz PPL(Phase Lock Loop)
- 采用 Single Transaction Translator (STT)技术,是*TT 系列中最具成本和效率方案
- 支持自供电到总线供电的自动枚举切换

2.2 充电支持

SL2.1A 支持标准的 BC1.2 充电协议。

第三章 电气特性

3.1 极限工作条件

表格 1: 最大额定值

符号	参数	最小值	最大值	单位
$\mathbf{V}_{ ext{DDM}}$	Power Supply	-0.5	+5.5	V
VIN	Input Voltage for digital I/O	-0.5	+5.5	V
VINUSB	Input Voltage for USB signal (DP, DM) pins	-0.5	+3.6	V
Ts	Storage Temperature under bias	-60	+100	${\mathbb C}$
Fosc	Frequency	$12 \text{ MHz} \pm 0.05\%$		

3.2 工作范围

表格 2: 工作范围

符号	参数	最小值	典型	最大值	単位
V_{DD}	Power Supply	4.0	5.0	5.25	V
VIND	Input Voltage for digital I/O pins	-0.5	3.3	5.5	V
VINUSB	Input Voltage for USB signal (DP, DM) pins	0.5	3.3	5.25	V
TA	Ambient Temperature	0	-	70	$^{\circ}\mathbb{C}$

3.3 直流电特性

表格 3: 直流电特性

符号	参数	最小值	典型	最大值	单位
I_{DD}	Supply Current	50	•	120	mA
I_{SUS}	Suspend Current	-	1	2.5	mA

3.4 HS/FS/LS 电气特性

参看 USB2.0 标准。

3.5 ESD 特性

本芯片端口 ESD 能力为±4KV(HBM)。

附录 封装

SL2.1A SOP16

· 尺寸	最小(mm)	最大(mm)	标注	最小(mm)	最大(mm)	
A	9.80	10.00	C32	0.05	0. 15	
A1	0. 356	0. 456	C4	0. 203	0. 233	
A2	1.2	7TYP	D	1. 05TYP		
A3	0. 3	02TYP	D1	0.40	0.70	
В	3. 85	3. 95	D2	0. 15 0. 25		
B1	5. 84	6. 24	R1	0. 20TYP		
B2	5. 0	0TYP	R2	0. 20TYP		
С	1.40	1.60	0 1	8° ∼ 12° TYP4		
C1	0.61	0.71	θ 2	$8^{\circ} \sim 12^{\circ} \text{ TYP4}$		
C2	0. 54	0.64	θ 3	0° ~ 8°		
C31	0.05	0. 25	θ 4	4° ∼ 12°		

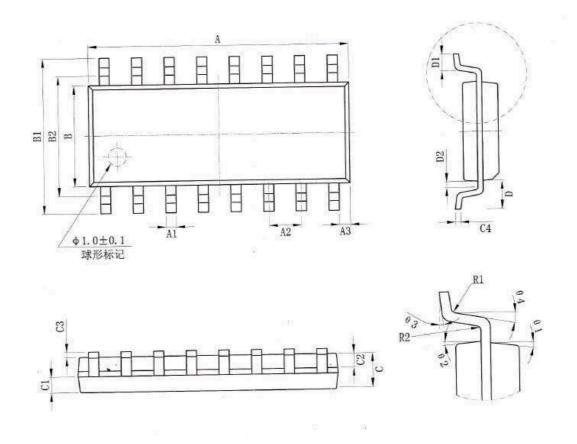


图 2: 封装尺寸图

